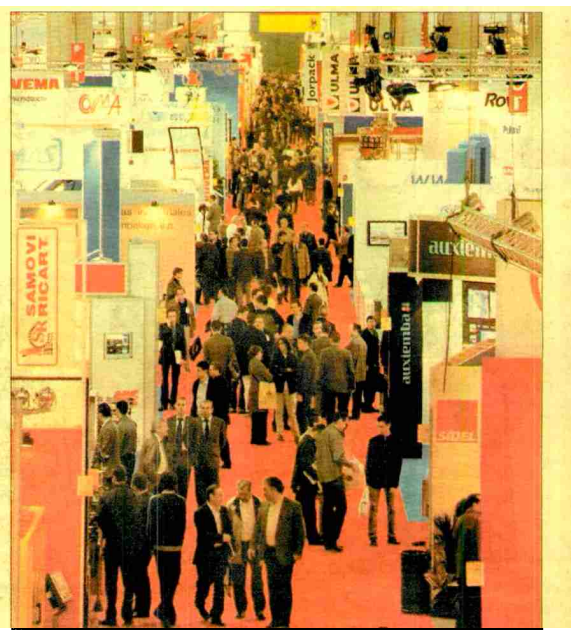




► Uno de los stands de la pasada edición de Hispack (izquierda), y vista general del salón.

GRAN VIA M-2 DEL 27 AL 31 DE MARZO

Hispack exhibe en BCN las últimas novedades del sector del embalaje

La feria reunirá cerca de 2.200 empresas repartidas en 857 stands

Hispack 2006, la mayor feria de embalaje de España y referente europeo de su especialidad, llegará puntual a su cita desde el 27 al 31 de marzo en el recinto Gran Vía de Fira de Barcelona. El certamen acogerá, en más de 55.000 metros cuadrados, a cerca de 2.200 empresas, repartidas en 857 stands con las últimas tendencias y novedades del mundo del envase y del embalaje y de la Publicidad en el Lugar de Venta (PLV).

Hispack, organizado por Fira de Barcelona y Graphispac Asociación, es un referente en España, Portugal, Francia, Italia, demás países mediterráneos y Latinoamérica. La previsión es que visiten el salón 35.000 profesionales de sectores industriales y de consumo, creadores publicitarios y diseñadores, técnicos e ingenieros vinculados a la I+D del sector.

GRUESO DE LA OFERTA El sector de la maquinaria y de los ac-

cesorios de envase y embalaje y el de las materias primas, materiales y productos auxiliares (que forman el 42% y el 28% de los expositores) integrarán el grueso de la oferta de Hispack. El resto (maquinaria para fabricación, recuperación y reciclaje; para embotellado y etiquetaje; la codificación y el marcaje; la logística y la manipulación, el PLV y los servicios) se distribuirán en los pabellones 1, 2 y 3.

En esta edición, los fabricantes de maquinaria darán un paso más

en los equipos automatizados, mejorando los flujos de trabajo digitales, la velocidad de las máquinas y la versatilidad de la producción. En materiales, la novedad es reducir el peso, aumentar la resistencia y mejorar el efecto barrera en plásticos, filmes y cartones.

El salón también presentará soluciones para mejorar la identificación, el etiquetado, la logística y la trazabilidad. En este ámbito, habrá demostraciones en el pabellón 2 sobre tecnología de identificación

por radiofrecuencia RFID/EPC, que revolucionará la fabricación, distribución y venta de productos.

MÁS INTERNACIONAL La actual edición será la más internacional de las celebradas hasta ahora, con un incremento del 34% de expositores extranjeros respecto al 2003 y la participación de 172 empresas de 21 países. Italia, con 60 empresas directas, será el país más representado, seguido de Francia y Alemania. También visitarán el salón delegaciones internacionales y habrá encuentros entre empresas europeas y latinoamericanas.

Entre las iniciativas de Hispack destacan la entrega de los Premios Líderpack, presididos por el consejero de Industria, Josep M. Rañé, el lunes, 27; la edición del Libro Blanco del Envase y Embalaje, y la exposición Pack & Food. ■

la agenda

26 de marzo

Congreso Internacional sobre 'materiales barrera'

Desde las 9.00 y hasta las 18.30 horas, el salón acogerá el primer encuentro Hispack de I+D en envases y embalajes *Últimos desarrollos en materiales barrera*. Se trata de un congreso científico en el que expertos de Japón, EEUU y varios países de la UE darán cuenta de las últimas aplicaciones de materiales plásticos para el diseño de envases. En concreto, se analizarán los avances en este campo, se mostrarán las nuevas líneas de investigación y se ofrecerán ejemplos prácticos en la protección de alimentos, fármacos, perfumes, productos del hogar y de aseo personal, sensibles a la presencia de oxígeno, humedad, gases y aromas. El encuentro se celebrará en el pabellón 3 del recinto de Gran Vía.

También comenzarán, de 10.00 a 19.00 horas, los encuentros empresariales Al Invest III. Se trata de unas reuniones



► Encuentro empresarial.

empresariales personalizadas, en las que participarán 30 empresas de Argentina, Brasil, Colombia y México y 60 compañías del sector del envase y embalaje de España, Italia y Alemania. El objetivo de la cita, que se desarrollará en el pabellón 2, será mejorar las relaciones comerciales entre empresarios de ambos lados de Atlántico.

29 de marzo

Innovación, ecodiseño y etiquetas inteligentes

En el pabellón 3 se celebrará, de 10.00 a 13.30 horas, la jornada *Innovación, diseño y certificación: Tres ejes fundamentales de la cadena de packaging*. Las ponencias tratarán de la innovación como herramienta de competitividad y de los nuevos materiales y procesos para la consolidación de un determinado producto. La preservación del medio ambiente será el elemento de reflexión del seminario técnico *Ecodiseño y análisis del ciclo de vida: metodología y casos prácticos de aplicación en envases y embalajes*. Desde las 10.00 y hasta las 14.00 horas, reconocidos profesionales explicarán en el pabellón 2 sus experiencias en el diseño de empaquetado respetuoso con el medio ambiente. También se analizarán los antecedentes legislativos sobre envases y residuos y se comentarán las previsiones sobre la implantación de nuevas normativas.



► Identificador de radiofrecuencia (RFID).

En el diseño de embalajes respetuosos con el medio ambiente, hay que añadir las Jornadas *RFID/EPC*, de 10.00 a 14.00 horas, sobre las ventajas de la aplicación de las etiquetas de identificación de radiofrecuencia en la cadena de suministro y sobre el futuro de esta tecnología hasta llegar a la internet de los objetos.